

WEST☐ Generate Collection

L6: Entry 55 of 55

File: DWPI

Jun 16, 2000

DERWENT-ACC-NO: 2000-457061

DERWENT-WEEK: 200040

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: HF component package for semiconductor device, has strip conductor extending from component mounting area on dielectric board to decrease side wall conductor length than quarter wavelength of signal.

PATENT-ASSIGNEE: KYOCERA CORP (KYOC)

PRIORITY-DATA: 1998JP-0334654 (November 25, 1998)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 2000164743 A	June 16, 2000		006	H01L023/02

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP2000164743A	November 25, 1998	1998JP-0334654	

INT-CL (IPC): H01 L 23/02; H01 L 23/12

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000164743A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Component mounting unit (1a) is formed on top surface of dielectric board (1) to mount high frequency component (6). Ground conductor (2) and line conductor (3) are brought near the vicinity of component mounting part. The line conductor extends to opposite along the side such that conductor length on the side wall is less than quarter wavelength of high frequency signal.

USE - In semiconductor package used in radio communication apparatus operating in microwave band.

ADVANTAGE - As side wall conductor length is less than quarter wavelength of signal frequency, increase of inductance and reduction of capacitance is avoided. Hence reflection of high frequency signal due to impedance match is prevented.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the sectional view and top view of high frequency package.

Dielectric board 1

Component mounting unit 1a

Ground conductor 2

Line conductor 3

High frequency component 6

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000164743A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/5

DERWENT-CLASS: U11
EPI-CODES: U11-D01A5;

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-164743

(P2000-164743A)

(43) 公開日 平成12年6月16日 (2000.6.16)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード (参考)
H 0 1 L 23/02		H 0 1 L 23/02	H
23/12	3 0 1	23/12	3 0 1 L

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平10-334654

(22) 出願日 平成10年11月25日 (1998. 11. 25)

(71) 出願人 000006833

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地

(72) 発明者 吉田 克亨

鹿児島県国分市山下町 1 番 1 号 京セラ株式会社国分工場内

(54) 【発明の名称】 高周波回路用パッケージ

(57) 【要約】

【課題】 側壁線路導体によって伝送線路が高インピーダンスとなり、高周波信号の反射が増大してしまう。

【解決手段】 下面または内部に接地導体層 2 が形成され、上面に高周波回路部品 6 の搭載部 1 a とその近傍から外周に至る線路導体 3 とが形成された誘電体基板 1 と、誘電体基板 1 の上面に接合された誘電体棒体 4 と、誘電体基板 1 の側面に線路導体 3 と連続的に形成された側壁線路導体 5 とから成り、側壁線路導体 5 の長さが線路導体 3 により伝送される高周波信号の波長の 4 分の 1 以下である高周波回路用パッケージである。側壁線路導体 5 のインピーダンスの増加を抑え、低反射の良好な伝送特性とすることができる。

